

LOCTITE GC 18

LOCTITE®pastanpaino

IDH2472657

LOCTITE GC 18 SAC305T3 885V 53U

- 25% vähemmän voideja BTC-QFN,DPAK ja LGA komponenteissa
- Hyvä juottuvuus vaativissa juotoksissa ja uunin profiileissa
- Erinomainen prosessikyvykyys vielä 12 tunnin printtauksen jälkeenkin
- Säilyvyys huoneenlämmössä, joka eliminoi romutuskuluja
- 100 x korkeampi lämpötilankestävyys kuin perinteisissä pastoissa



TUOTEKUVAUS

Henkel on julkaissut uuden pastan palkitun huoneenlämmössä säilytettävän LOCTITE® GC 10 tuotteen jatkoksi.

Henkel on tuonut markkinoille viimeisimmän tuotteen LOCTITE GC 18 LOCTITE GC -sarjaan. LOCTITE GC 18 ylläpitää vaativat suorituskykyominaisuudet SMT -ympäristöissä, säilyttäen vakauden 6 kuukautta, kun sitä säilytetään 26,5 ° C: ssa, yhden kuukauden ajan jopa 40 ° C lämpötilassa.

Tämä materiaali on suunniteltu parantamaan finepitch-komponenttien siirtotehokkuutta ja sillä on hyvä juoksevuus haastavissakin pinnoitteissa. GC 18 -juotospasta takaa myös luotettavan juottuvuuden niin ilma- kuin tyypijuotosprosesseissa sisältäen OSP-, ENIG- ja hopeapinnoitteet.

GC 18 vähentää myös ilmakuplia chipvastuksissa (CR), chip-kondensaattoreissa (CC), SOIC-, BGA-, QFP- ja kaikenlaisissa QFN-komponenteissa.

Kestävyys on suunniteltu LOCTITE GC 18 ominaisuuksiin, jotta se vähentää tarvetta kalliille tyypijuotosprosesseille, vähentää reworkin kustannuksia sekä vähentää PPM-virheitä.

GC 18 -pastaa on saatavilla SAC305 T3 sekä T4-versioina.